



DISCO KKM(切削磨)

~ 校园技术专题讲座 ~

半导体芯片技术的发展趋势 晶圆技术和芯片加工课题

Memory : 加工方法不当会失去电子特性?
Logic : 脆弱的Low-k层一碰就碎如何切割?
MEMS : 立体结构弱不禁风,如何切割成芯片?
Power Device : 比纸还薄的晶圆如何搬送去背金?

好产品 = 好设计+好制作(晶圆)+好加工(芯片)

- 时间: 2016年10月19日(星期三) 13:30-16:00
- 地点: 上海交大闵行校区 微电子大楼401室

主办者: DISCO中国 KKM学院

主讲人: 冷雪青 DISCO集团总部营业技术部

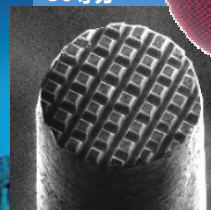


2012年 DISCO总部 营业技术部 (市场Group)
2011年 DISCO总部 亚太地区本部 (本部长助理)
2005年 DISCO中国 应用开发部经理 兼刀片磨轮销售部经理
1996年 DISCO总部 应用开发部 (研发组 Team Leader)
1988年 上海工业大学 机械系
1996年 东京大学大学院 机械科(材料力学)硕士

「高度なKiru・Kazuru・Migaku技術によって
遠い科学を身近な快適につなぐ」

5 μ m 薄晶片
能透光

头发截面的
36等分



<http://www.discochina.com>